证券代码：603061 证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	☑ 特定对象调研 ☐ 线上分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☑ 路演活动 ☑ 现场访谈 ☑ 线上调研 ☐ 其他
参与单位名称	中邮证券、鹏华基金、长城财富保险资管、长盛基金、天风证券、中信证券、瑞银证券、国泰基金、南方基金、光大保德信基金、安信基金、长城基金、前海开源基金、信达澳亚基金、中银基金、国联基金、富安达基金、华宝基金、申万菱信基金、国金基金、融通基金、东方阿尔法基金、平安基金、长信基金、建信基金、易方达基金、华安基金、国海富兰克林基金、永赢基金、创金合信基金、汇添富基金、广发基金、富国基金、银华基金、中金资管、嘉实基金、浦银基金、新华基金、国联安基金、东方基金、睿远基金、诺安基金、中信保诚基金、银河基金、中邮人寿、嘉合基金、汇丰晋信基金、交银施罗德基金、鹏扬基金、国寿安保基金、长江证券、平安资产、兴业证券、兴全基金、海富通基金、中泰证券、华商基金、华泰柏瑞基金、招商基金、泰康资产、华夏基金、民生加银基金（以上排名不分先后）。
时间	2026 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 29 日
地点	公司会议室、腾讯会议、策略会现场、路演现场等。
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。

投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍主要内容 金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。 公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。 公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已与同类产品的国际先进水平同步。 二、公司 2026 年前三季度经营情况介绍 2026 年前三季度，受 AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的驱动，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求持续增长，叠加公司全球化业务布局成效逐步显现，境外市场订单较上年同期实现较好增长。因此，2026 年前三季度，公司产品测试分选机销量实现较大提升，公司业绩实现较好的增长。2026 年前三季度，公司实现营业收入 10.01 亿元，较上年同期增长 107.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.24 亿元，较上年同期增长 159.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.20 亿元，较上年同期增长 163.71%；经营活动现金流量净额达到 2.46 亿元，同比增长 391.98%。截至 2026 年 9 月末，公司总资产为 28.77 亿元，较上年末增长 33.84%；截至 2026 年 9 月末，公司净资产为 19.61 亿元，较上年末增长 21.47%。 2026 年第三季度，公司营业收入 4 亿元，同比增长 129.62%，环比增长 26.25%；实现归母净利润 1.53 亿元，同比增长 211.52%，环比增长 72.06%。 公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。

	同时，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。公司积极拓展新增客户群体，持续深化既有客户合作关系，全面强化客户服务能力建设。 三、调研问答 1、问：本期业绩增长的主要原因？ 答：2026 年第三季度，公司营业收入 4 亿元，同比增长 129.62%，环比增长 26.25%；实现归母净利润 1.53 亿元，同比增长 211.52%，环比增长 72.06%。受 AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的驱动，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求持续增长，叠加公司全球化业务布局成效逐步显现，境外市场订单较上年同期实现较好增长，因此，公司产品测试分选机销量实现较大提升，公司业绩实现较好的增长。 2、问：公司目前的下游需求持续性如何？ 答：公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。 在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下，2025 年全球半导体行业延续增长态势，先进封装、AI 及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会（SIA）数据显示，2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元，较 2024 年同比增长 25.6%，创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体市场规模预计同比增长 22.5%。上述驱动因素动能的持续释放，将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。 特别是随着先进封装、AI 算力芯片等的发展，相关芯片测试的复杂度在攀升，芯片测试总耗时大幅提高，对高端测试资源的需求在快速增加；与此同时，相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面，对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。 未来，集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工，为确保产品质量、生产效率和生产稳定

	性，半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发，产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性对分选机设备不断提出更高要求，测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。 3、问：新产能建设方面，比如正在建设的上海澜博半导体设备制造中心供应链与人员储备会面临哪些挑战？ 答：上海澜博半导体设备制造中心建设项目，以复用公司现有成熟供应链体系为主，供应链无需做出重大调整；新基地物料流转磨合、技能人员培育属于投产过程中客观存在的挑战。公司已制定人员储备及厂区供应链适配方案，项目各项筹备及实施工作有序推进。 4、问：公司现有产品的迭代是从哪几个方面进行的？ 答：公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。 5、目前客户下单的节奏大概是什么节奏（提前多久下单）？ 答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。 6、请问公司发行可转债项目的进展如何？ 答：公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请，已于 2026 年 9 月 23 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的相关公告。 7、问：在海外业务布局和国际市场开拓上，公司主要有哪些策略？ 答：公司自成立以来，一直以国际市场需求为导向，坚持“国际化定位”，这一定位将在未来长期坚持。在积极开拓境内市场的同时，公司重点跟进境外头部 IDM、OSAT 以及设计公司等头部企业快速迭代

	的产品及测试分选需求。公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。公司“马来西亚生产运营中心”助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。
附件清单（如有）	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 10 月 30 日